

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 截至二零一五年九月三十日止三個月之 第三季度未經審核業績公布

#### ASMPT 的 SMT 解決方案業務晉升全球第一 穩佔後工序設備業務全球之首

- 集團收入為 4.169 億美元，較前一季度及去年同期分別減少 14.1% 及 33.4%
- 盈利為港幣 1.802 億元，較前一季度及去年同期分別減少 58.9% 及 77.0%
- 二零一五年第三季度每股盈利為港幣 0.45 元
- 後工序設備業務收入為 1.878 億美元，較前一季度及去年同期分別減少 21.8% 及 32.9%
- SMT 解決方案業務收入為 1.751 億美元，較前一季度及去年同期分別減少 6.5% 及 37.8%
- 物料業務收入為 5,400 萬美元，較前一季度及去年同期分別減少 6.6% 及 16.8%
- 新增訂單總額為 3.809 億美元，較前一季度及去年同期分別減少 22.9% 及 28.5%
- 於二零一五年九月底的現金及銀行存款結存為港幣 21.0 億元

ASM Pacific Technology Limited 董事會欣然宣布截至二零一五年九月三十日止第三季度及九個月之未經審核業績如下：

## 業績

謹此欣然報告，ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASMPT」）於截至二零一五年九月三十日止三個月錄得收入為港幣32.3億元(4.169億美元)，較去年同期的港幣48.5億元(6.261億美元)減少33.4%，亦較前三個月的收入港幣37.6億元(4.853億美元)減少14.1%。

集團三個月的綜合除稅後盈利為港幣1.802億元，較二零一四年同期減少77.0%，亦較前三個月減少58.9%。三個月期間的每股基本盈利為港幣0.45元（二零一四年第三季度：港幣1.96元，二零一五年第二季度：港幣1.09元）。

集團於截至二零一五年九月三十日止九個月錄得收入為港幣100.5億元，較去年同期的港幣107.8億元減少6.8%。集團首九個月的綜合除稅後盈利為港幣9.031億元，較二零一四年同期減少33.4%。

# 財務概要

## 簡明綜合損益表

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月		
	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元	
	附註				
收入	1	3,231,077	4,852,395	10,048,895	10,783,468
銷貨成本		(2,135,704)	(3,115,014)	(6,420,019)	(7,041,902)
毛利		1,095,373	1,737,381	3,628,876	3,741,566
其他收益		21,810	52,345	34,760	60,101
銷售及分銷費用		(311,422)	(334,003)	(942,621)	(834,269)
一般管理費用		(186,737)	(171,910)	(548,048)	(444,219)
研究及發展支出		(297,406)	(326,741)	(879,042)	(833,766)
其他收益及虧損		(13,225)	66,205	38,812	83,476
財務費用		(39,793)	(38,389)	(116,747)	(81,600)
重組成本		(21,262)	-	(21,262)	-
除稅前盈利		247,338	984,888	1,194,728	1,691,289
所得稅開支		(67,110)	(202,494)	(291,644)	(335,063)
本期間本公司持有人應佔盈利		180,228	782,394	903,084	1,356,226
每股盈利	3				
- 基本		港幣 0.45 元	港幣 1.96 元	港幣 2.24 元	港幣 3.39 元
- 攤薄		港幣 0.45 元	港幣 1.92 元	港幣 2.24 元	港幣 3.38 元

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元
本期間本公司持有人應佔盈利	<b>180,228</b>	782,394	<b>903,084</b>	1,356,226
其他全面支出				
其後可能會被重新分類至損益之 換算海外營運公司匯兌差額	<b>(116,905)</b>	(173,380)	<b>(309,263)</b>	(199,374)
本期間本公司持有人應佔全面 收益總額	<b>63,323</b>	609,014	<b>593,821</b>	1,156,852

附註：

## 1. 分部資料

本集團以可報告之經營分部的收入和業績分析如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元
<b>對外客戶分部收入</b>				
後工序設備	1,455,138	2,168,202	4,682,987	5,288,107
表面貼裝技術(「SMT」)解決方案	1,357,693	2,181,325	4,058,367	4,044,042
物料	418,246	502,868	1,307,541	1,451,319
	<b>3,231,077</b>	<b>4,852,395</b>	<b>10,048,895</b>	<b>10,783,468</b>
<b>分部盈利</b>				
後工序設備	166,583	563,880	674,349	1,123,496
SMT 解決方案	135,795	365,270	543,128	494,048
-未計入因收購 DEK 業務資產之 公平值增值攤銷之盈利	147,584	365,270	578,499	494,048
-因收購 DEK 業務資產之公平值 增值之攤銷	(11,789)	-	(35,371)	-
物料	34,869	43,666	117,252	137,647
	<b>337,247</b>	<b>972,816</b>	<b>1,334,729</b>	<b>1,755,191</b>
利息收入	1,544	1,760	5,071	6,410
財務費用	(39,793)	(38,389)	(116,747)	(81,600)
未分配其他收益	217	168	217	269
未分配外幣淨匯兌(虧損)收益	(14,662)	65,622	34,732	55,403
未分配一般管理費用	(15,953)	(17,089)	(42,012)	(44,384)
重組成本	(21,262)	-	(21,262)	-
除稅前盈利	<b>247,338</b>	<b>984,888</b>	<b>1,194,728</b>	<b>1,691,289</b>
<b>分部盈利之百分比</b>				
後工序設備	11.4%	26.0%	14.4%	21.2%
SMT 解決方案				
-未計入因收購 DEK 業務資產 之公平值增值之攤銷	10.9%	16.7%	14.3%	12.2%
-計入因收購 DEK 業務資產之 公平值增值之攤銷	10.0%	16.7%	13.4%	12.2%
物料	8.3%	8.7%	9.0%	9.5%

## 2. 截至二零一五年九月三十日止三個月季度的分部營業額及業績分析

	截至二零一五年			變動	
	九月三十日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	六月三十日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	三月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	第三季度 與 第二季度 比較	第三季度 與 第一季度 比較
<b>對外客戶分部營業額</b>					
後工序設備	1,455,138	1,861,559	1,366,290	-21.8%	6.5%
SMT 解決方案	1,357,693	1,452,576	1,248,098	-6.5%	8.8%
物料	418,246	447,817	441,478	-6.6%	-5.3%
	<b>3,231,077</b>	<b>3,761,952</b>	<b>3,055,866</b>	<b>-14.1%</b>	<b>5.7%</b>
<b>分部盈利</b>					
後工序設備	166,583	336,511	171,255	-50.5%	-2.7%
SMT 解決方案	135,795	241,538	165,795	-43.8%	-18.1%
-未計入因收購 DEK 業 務資產之公平值增值 攤銷之盈利	147,584	253,328	177,587	-41.7%	-16.9%
-因收購 DEK 業務資產 之公平值增值之攤銷	(11,789)	(11,790)	(11,792)	-	-
物料	34,869	40,470	41,913	-13.8%	-16.8%
	<b>337,247</b>	<b>618,519</b>	<b>378,963</b>	<b>-45.5%</b>	<b>-11.0%</b>
利息收入	1,544	1,568	1,959	-1.5%	-21.2%
財務費用	(39,793)	(39,158)	(37,796)	1.6%	5.3%
未分配其他收益	217	-	-	不適用	不適用
未分配外幣淨匯兌(虧損)收益	(14,662)	(20,151)	69,545	-27.2%	不適用
未分配一般管理費用	(15,953)	(16,693)	(9,366)	-4.4%	70.3%
重組成本	(21,262)	-	-	不適用	不適用
除稅前盈利	<b>247,338</b>	<b>544,085</b>	<b>403,305</b>	<b>-54.5%</b>	<b>-38.7%</b>
<b>分部盈利之百分比</b>					
後工序設備	11.4%	18.1%	12.5%		
SMT 解決方案					
-未計入因收購 DEK 業務資 產之公平值增值之攤銷	10.9%	17.4%	14.2%		
-計入因收購 DEK 業務資產 之公平值增值之攤銷	10.0%	16.6%	13.3%		
物料	8.3%	9.0%	9.5%		

### 3. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 (未經審核) 港幣千元	二零一四年 (未經審核) 港幣千元
計算每股基本盈利之應佔盈利 (本期間盈利)	180,228	782,394	903,084	1,356,226
加：可換股債券之利息支出 (附註)	-	35,912	-	-
計算每股攤薄盈利之應佔盈利 (本期間盈利)	<u>180,228</u>	<u>818,306</u>	<u>903,084</u>	<u>1,356,226</u>
	股份之數量 (以千位計)		股份之數量 (以千位計)	
計算每股基本盈利之普通股 加權平均股數	402,297	400,423	402,434	400,491
潛在攤薄影響之股數				
- 僱員股份獎勵制度	1,531	1,623	1,076	1,133
- 可換股債券(附註)	-	24,437	-	-
計算每股攤薄盈利之普通股 加權平均股數	<u>403,828</u>	<u>426,483</u>	<u>403,510</u>	<u>401,624</u>

附註： 計算截至二零一五年九月三十日止三個月，二零一五年及二零一四年九月三十日止九個月之每股攤薄盈利並無計入本公司之未行使可換股債券的兌換，因為計算該兌換將增加每股盈利。

計算截至二零一四年九月三十日止三個月之每股攤薄盈利時，假設本公司之未行使可換股債券已完全兌換為普通股，並已調整盈利以抵銷有關可換股債券之利息支出。

## 業務回顧

鑒於中國及新興市場的經濟出現放緩、美元轉強以及商品價格持續下跌，市場情緒自今年八月以來迅速轉淡。此不利的宏觀經濟狀況削弱了整體市場信心及全球需求。集團留意到客戶縮減資本性支出預算以及推遲他們的訂單。在某些情況下更推遲已下訂單之付運，這與經濟活動的放緩情況一致。行業分析員亦已紛紛調低對半導體裝嵌及封裝設備行業的預測，預期有關行業於今年及二零一六年將會收縮。

基於這負面的市場情緒，集團於二零一五年第三季度的營業額按季減少 14.1%。於今年第二季度末，本集團基於當時尚未完成訂單總額處於良好水平，而預期二零一五年第三季度的營業額將與前一季度相若。

集團二零一五年第三季度的營業額為 4.169 億美元，較去年同期減少 33.4%。集團全部三個業務分部的營業額均按年及按季減少。二零一五年首九個月的營業額較去年同期減少 6.8%。

於第三季度，集團的新增訂單總額為 3.809 億美元，較去年同期減少 28.5%，及較二零一五年第二季度減少 22.9%。全部三個業務分部的訂單均按年減少。於二零一五年第三季度，物料業務的新增訂單總額保持與前一季度相若，連續五個季度持平。

集團於首九個月錄得較低的訂單總額，為 13.4 億美元，比去年同期減少 14.6%。

二零一五年第三季度的訂貨對付運比率為 0.91。於二零一五年九月三十日，未完成訂單總額為 4.035 億美元，較前一季度減少 8.6%。

集團於二零一五年第三季度之營業額按地區劃分的五大市場為中國（包括香港）(49.9%)、歐洲(16.5%)、馬來西亞(7.2%)、美洲(6.4%)及菲律賓(3.9%)。值得注意的是，台灣首次不在此列，這或反映該市場情況充滿挑戰。

## 業務回顧（續）

集團的盈利能力因營業額減少而受到負面影響。集團於二零一五年第三季度及首九個月的盈利分別為港幣 1.802 億元及港幣 9.031 億元。為應對未來的挑戰，集團推出了積極的成本削減計劃。今年九月，集團為中國製造部的員工推出自願離職獎勵計劃。於二零一五年十月二十二日，集團又公布精簡其 SMT 解決方案製造業務的計劃。集團 DEK 印刷機業務位於中國深圳的現有製造設施將於今年年底前結束營運，該業務將與集團位於新加坡及馬來西亞的現有製造業務合併，預計這兩項舉措將減少約 360 名員工。由這兩項舉措所產生的離職相關開支中約港幣 2,130 萬元已計入集團今年第三季度的財務業績之內，其餘部分約港幣 1,620 萬元將納入集團今年第四季度的財務業績之內。預計此兩項舉措每年可減省成本約港幣 4,850 萬元。

儘管市場環境充滿挑戰，集團相信其多元化的客戶基礎及應用市場將有助集團於此期間的表現優於同業及市場。

### 後工序設備業務

於二零一五年第三季度，後工序設備業務的營業額為 1.878 億美元，較前一季度和去年同期分別減少 21.8% 及 32.9%。於今年首九個月及第三季度，後工序設備業務分別佔集團總營業額的 46.6% 及 45.0%。儘管市場環境充滿挑戰，集團的後工序設備業務於今年首九個月期間仍能持續增加市場的佔有率。

後工序設備的訂單較今年第二季度及去年同季分別減少 29.1% 及 33.6%。由年初至今，訂單比去年同期減少了 20.3%。

於第三季度期間，用於組裝 CMOS 影像感應器（「CIS」）的設備、用於生產少輸入輸出端器件的高速覆晶焊接機及用於測試小型器件的測試處理機的訂單及營業額表現持續優於其他產品，甚至按年錄得增加。事實上，集團的高速覆晶焊接機於少輸入輸出端器件應用市場的市場佔有率遠高過 50%。同樣地，集團於測試 0603 小型器件的測試處理機的市場佔有率亦超越 50%。於 LED 市場，集團已將其在市場上的領導地位從傳統包裝領域擴展至晶圓級覆晶 LED 市場。集團相信這印證其針對先進包裝市場策略的成功，而服務多元化應用市場將繼續有利集團的發展。

後工序設備業務於過去三個月錄得毛利率 39.2% 及分部盈利率 11.4%。後工序設備業務的毛利率較前一季度減少 1.9%（185 點子），主要是由於第三季度收入減少所致。

## 業務回顧（續）

### 物料業務

物料業務於二零一五年第三季度的營業額為 5,400 萬美元，較二零一五年第二季度及二零一四年第三季度分別減少 6.6% 及 16.8%。物料業務佔集團今年第三季度總營業額的 13.0%。

物料業務於九個月期間的營業額為 1.687 億美元，較去年同期減少了 9.9%。

物料業務的新增訂單總額與上一季度水平相若（減少 0.8%），較去年同季則減少 4.9%。

於二零一五年首九個月，物料業務的訂單較去年同期減少 11.2%。

於二零一五年第三季度，物料業務錄得毛利率 16.0% 及分部盈利率 8.3%。物料業務的毛利率較前一季度及去年同期分別增加 0.6%（61 點子）及 2.8%（278 點子）。

為進一步加強物料業務，集團於二零一五年十月二十三日宣布投資模塑互連基板（「MIS」）業務。近年，ASMPT 積極投資於先進封裝設備解決方案，憑藉於 MIS 的投資，集團得以擴大其先進封裝物料產品組合，從而為客戶提供更廣泛的封裝解決方案。

### SMT 解決方案業務

SMT 解決方案業務於二零一五年第三季度的營業額為 1.751 億美元，較二零一五年第二季度及二零一四年同季分別減少 6.5% 及 37.8%。相對按年較大的減幅，主要是由於去年集團接獲一張大額訂單所致。於二零一五年第三季度，SMT 解決方案業務佔集團總營業額的 42.0%。

由年初至今，SMT 解決方案業務的營業額為 5.234 億美元，較去年同期增加 0.4%。

SMT 解決方案業務的訂單較二零一四年第三季度及二零一五年第二季度分別減少 29.0% 及 21.7%。

今年首九個月的新增訂單總額較去年同期減少 8.0%。

## 業務回顧（續）

集團的 SMT 解決方案業務持續表現良好。根據現有的市場數據，集團相信已於過去九個月超越同業，並已成為 SMT 設備市場的最大供應商，較集團的原定計劃提前一年達標。

於二零一五年第三季度，SMT 解決方案業務錄得毛利率 33.8% 及分部盈利率 10.0%。SMT 解決方案業務的毛利率較前一季度減少 6.7%（670 點子）。毛利率下滑主要是受到該季度收入減少，以及產品和地區組合的影響。通常情況下，集團 SMT 解決方案業務每年第三季度的收入較多來自亞洲，而預期在每年最後一個季度的收入則較多來自歐洲。SMT 解決方案業務的毛利率較去年同期增加 0.2%（24 點子）。

## 展望

在目前的市場情緒及不明朗的全球宏觀經濟前景下，集團預期第四季度將會充滿挑戰。營業額及訂單或將持續減少。整體而言，集團預測二零一五年的營業額或較去年呈低雙位數百分比的降幅。然而，集團相信憑藉廣泛的客戶基礎及多元化的應用市場將繼續讓集團處於穩守有利位置。

集團對半導體裝嵌及封裝設備行業的長遠前景仍然充滿信心。集團相信，隨著更多設備實現連線，與物聯網（「IoT」）發展相關的需求將持續上升。行業分析員預測，連線設備的數目將於物聯網時代增加至逾數百億件，為集團締造龐大的增長機遇。此外，市場不斷要求更小巧、更纖薄並具備更佳電子性能及導熱能力的產品，將有利於集團發展。集團憑藉本身具備的半導體後工序及 SMT 設備技術及專業知識，以及完善的先進封裝解決方案，將能與客戶合作開發他們所需的解決方案。

## 賬目審閱

審核委員會已審閱集團截至二零一五年九月三十日止九個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

## 董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事：Arthur H. del Prado 先生（主席）、李偉光先生、周全先生及黃梓達先生；非執行董事：Charles Dean del Prado 先生及 Petrus Antonius Maria van Bommel 先生；獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐、樂錦壯先生、黃漢儀先生及鄧冠雄先生。

承董事會命  
董事  
李偉光

香港，二零一五年十月二十八日